

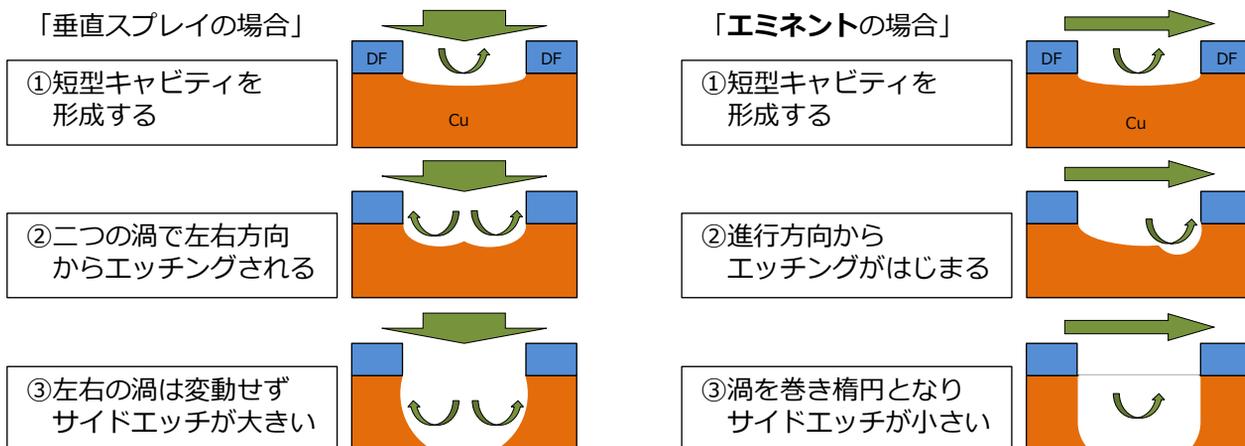
エミネントシリーズ

特許取得済

プリント基板のエッチングで最も厄介な問題は、基板上面の液溜りであり、各社は様々な対処方法を駆使しています。当社は、品質の向上・メンテナンス性・薄板の安定搬送を併せ持つ「エミネント方式」という独自の技術で、この問題を解決しました。

「エミネント方式」とは

垂直方向の吐出流は、エッチングが進むにつれて液交換が遅くなり、縦方向へのエッチングが遅くなることで、サイドエッチが大きくなってしまいが、水平吐出流は、キャビティー内で渦が発生することで液交換が素早く行え、エッチングが進んでも液交換がスムーズに行われ、縦方向のエッチングが阻害されないことから、サイドエッチが少ないと考えられています。



基板の流し方向前後への液拡散を防止して、強制的な液流れを作る事で基板上面の液溜りを解消するとともに、ユニフォミティーも改善されました。

